



## BAMFIT Bonder / Tester 5600

### Test System

<b>Testkopf</b>	Das speziell entwickelte Klemmwerkzeug greift den Bondfuß seitlich bei definierter Höhe; ein Touchdown-System gleicht Variierende Substrathöhen automatisch aus.
<b>Testwerkzeug</b>	für Dickdrähte von 125 bis 500 µm; für Ball-Bonds ab 50 µm Drahtstärke; durch den Bediener in Minuten austauschbar
<b>Testkraft</b>	Zugkraft in Z-Richtung, typ. 20 bis 40 cN
<b>Testfrequenz</b>	60 und 80 kHz, programmierbarer Ultraschall-Generator
<b>Testamplitude</b>	entspricht dem Temperaturhub beim PC Test; programmierbar von 0 bis 1 µm
<b>Testdaten</b>	Toolposition und Ultraschalldaten werden laufend registriert und zur späteren Auswertung in SQL-Datenbank gespeichert

### BAMFIT-Tester

Das revolutionäre **BAMFIT-Testverfahren** ist durch einen speziellen Testkopf sehr einfach an jedem Basisgerät der Serie 56XX installierbar.

Die Software ist der Standard-Version für Bonder und Tester sehr ähnlich und erlaubt voll-automatisches Testen von beliebig vielen Bonds mit automatischer Feinjustierung der Testposition durch Bilderkennung.

Die Testresultate werden in einer SQL-Datenbank gespeichert und können jederzeit ausgewertet werden.

### BAMFIT Zuverlässigkeits-Test

**BAMFIT (Bond Accelerated Mechanical Fatigue Interconnection Test)** ist ein völlig neuartiges Testverfahren, um Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Dickdraht-Wedgebonds und Dünndraht-Ballbonds abzuschätzen. Es ist die perfekte Erweiterung des klassischen Power-Cycling-Tests (PC): die zyklische Stressbelastung des Drahtbonds durch Temperaturwechsel wird durch mechanischen Stress nachgebildet, aber mit bedeutend höherer Zyklusgeschwindigkeit. Dadurch können PC-Tests, die häufig Wochen oder Monate dauern, innerhalb von Minuten simuliert werden.

## Maschinenbasis

<b>Arbeitsbereich</b>	X/Y-Achse 100x100 mm / Z-Achse 60 mm
<b>Achsen</b>	Schrittauflösung 0,25 µm; Wiederholgenauigkeit <2 µm
<b>Testkopf</b>	Austauschbare Bond- und Testköpfe mit automatischer Erkennung
<b>Hardware</b>	Dual Core PC, 1,6 GHz Prozessor, 4 GB RAM, Ethernet, 4x USB-Hub Front, Firewire CCD Farbkamera mit programmierbarer Bilderkennung
<b>Software</b>	Manuelle oder automatische Messungen an beliebig vielen Bonds
<b>Abmessung</b>	B x T x H – 70 x 65 x 70 cm, Gewicht ca. 80 kg
<b>Anschlüsse</b>	100-240 VAC, 1 Phase, 50/60 Hz, max. 500 VA Standard-Vakuumschlauch Ø 6 mm

### F&S Bondtec Semiconductor GmbH

Industriezeile 49a  
A-5280 Braunau am Inn  
Tel.: +43-7722-67052-8270  
Fax: +43-7722-67052-8272  
Mail: [info@fsbondtec.at](mailto:info@fsbondtec.at)  
Web: [www.fsbondtec.at](http://www.fsbondtec.at)

**Hilpert**  
electronics

Ihr Vertriebspartner/ Votre représentant:  
Hilpert electronics AG  
Täferstrasse 29  
5405 Baden-Dättwil  
Schweiz / Suisse  
Tel: +41 56 483 25 25  
Fax: +41 56 483 25 20  
Mail: [office@hilpert.ch](mailto:office@hilpert.ch)  
Web: [www.hilpert.ch](http://www.hilpert.ch)

